

系統晶片設計學分學程課程課程規劃表

課程種類	課程名稱	開課單位	開課學期	學分	成績 (自行填入)	認證	備註
核心課程 (至少應修習及格達2門)	數位系統設計	電子工程學系/ 電機工程學系	2上	3			學分學程必修
	電子學三	電子工程學系/ 電機工程學系	3上	3			
	積體電路設計導論	電子工程學系	3下	3			
實驗課程 (至少應修習及格達1門)	FPGA設計與實驗#/ FPGA系統設計實驗#	電子工程學系/ 電機工程學系	3上/ 3下	1			
	嵌入式系統實驗#	電子工程學系	3下	1			(隔年開)
	積體電路製程模擬實驗	電子工程學系	4上	1			
	半導體元件模擬實驗	電子工程學系	4下	1			
輔助課程	計算機組織#/ 計算機組織與結構#	電子工程學系/ 資訊工程學系	2下/ 3上	3			
	半導體元件物理	電子工程學系	3上	3			
	數位系統快速雛形設計#	電子工程學系	3上	3			
	微處理機原理#/ 微處理機#/ 微處理器系統#	電子工程學系/ 電機工程學系/ 資訊工程學系	3上/ 2上/ 2上	3			
	作業系統原理#/ 作業系統#	電子工程學系/ 資訊工程學系	3上	3			
	VLSI元件設計與模型	電子工程學系	3下	3			
	計算機結構	電子工程學系	3下	3			(隔年開)
	數位積體電路設計	電子工程學系	4上	3			
	處理器設計與實作	電子工程學系	4下	3			
	微感測器及感測 電路設計	電子工程學系	3下	3			
	半導體工程	電子工程學系	4上	3			106新增
	DSP 積體電路設計	電子工程學系	4上	3			106新增

105 學年度第 07 次系務會議(106.03.22)通過，將「半導體工程」列為本學分學程之輔助課程。

105 學年度第 05 次課程委員會會議(106.04.12) 通過，將「DSP 積體電路設計」列為本學分學程之輔助課程。